

群聯攜手 Intel 將邊緣 AI 工作負載導入 Intel AI PC 平台

Phison Pascari aiDAPTIV™ 突破 PC 本地記憶體限制

支援更大型 MoE AI 模型與代理式 AI 應用

台北 COMPUTEX — 2026 年 6 月 2 日 — 全球最大的獨立 NAND 控制晶片暨 NAND 儲存方案供應商 群聯電子 (Phison Electronics, 8299TT) 今日宣布與 Intel 展開合作，攜手推動 AI PC 可於地端執行更大型、更高能力的 AI 應用。此次合作結合 Intel® Core™ Ultra Series 3 處理器與群聯 Pascari aiDAPTIV 記憶體延伸技術，突破傳統系統記憶體容量限制，使 AI PC 得以支援更大型 Mixture-of-Experts (MoE) AI 模型、更長時間的 AI 工作階段，以及代理式 AI (Agentic AI) 工作流程。



現今 AI PC 已逐步從單純 AI 助理應用，演進至更進階的地端 AI 使用情境。相關應用已能協助終端使用者與企業進行文件分析、多步驟工作流程執行，以及敏感資料保護，同時降低對純雲端 AI 服務的依賴。然而，這類 AI 工作負載通常需要更大型 AI 模型、持續性工作階段狀態 (Persistent Session State)，以及大量記憶體資源，使市場對下一代具備更高記憶體能力的 AI PC 平台需求快速提升。

aiDAPTIV 正是為解決此問題而打造。透過 Pascari aiDAPTIV Cache Memory，aiDAPTIV 可將 AI 工作記憶體延伸至系統 DRAM 與高效能、高耐久度 NAND Flash 之間，建立全新的 AI

記憶體架構。藉由降低部分地端 AI 工作負載對 DRAM 的需求，並支援 KV Cache Reuse 等執行階段功能，aiDAPTIV 能協助更大型 AI 工作負載於 Intel AI PC 平台上實現地端運作。

根據群聯內部測試，在相同測試環境下，搭載 aiDAPTIV 的系統僅需 16GB DRAM，即可執行 260 億（26B）參數 AI 模型；若未使用 aiDAPTIV，則需 32GB DRAM 才能完成相同工作負載。

此次合作聚焦於將群聯 aiDAPTIV 技術導入搭載 Intel Core Ultra 處理器的 Intel AI PC 平台，並支援 OpenVINO 工具套件。群聯與 Intel 亦將共同推動 ISV 軟體驗證、技術展示與效能最佳化工作負載開發。

群聯電子創辦人暨執行長 潘健成 (K. S. Pua) 表示：「AI PC 正快速演進為可執行更複雜地端 AI 工作負載的平台，包括代理式 AI 應用與更大型 MoE 模型，而這些應用對記憶體容量與系統反應能力的需求也持續提升。透過與 Intel 的合作，aiDAPTIV 能有效擴展 Intel AI PC 平台可用於 AI 工作負載的記憶體資源，協助 OEM 廠商、開發者與終端使用者，在兼顧資料隱私與基礎架構效率的前提下，於地端執行更高能力的 AI 應用。」

於 COMPUTEX 展會期間，群聯將展示多項搭載 aiDAPTIV 技術的 Intel AI PC 平台應用示範。群聯與 Intel 將現場展示一套地端聊天介面 (Local Chat UI)，執行原本超出系統記憶體容量限制的 MoE AI 模型，呈現 aiDAPTIV 如何透過 Pascari aiDAPTIV Cache Memory 擴展 AI 工作記憶體。

此外，群聯也將展示基於 OpenClaw 開源 AI Agent 框架所打造的 Hybrid LLM Routing 混合式大型語言模型路由應用。該方案可透過 aiDAPTIV 於地端執行更大型 MoE AI 模型，大幅降低雲端 Token 使用成本，同時在需要更高階 AI 推理能力時，仍可彈性切換至雲端 AI 模型處理複雜請求。

群聯展位亦將展示來自 AI 軟體生態系夥伴的應用成果，包括 Ollama、LLMWare、TurinTech、與 Intel® AI Superbuilder and Intel® AI Playground，展示 aiDAPTIV 如何應用於真實地端 AI 情境。同時，現場也將展示與 ASUS、MSI 與 Acer 等硬體平台合作夥伴的整合成果。

Ollama 共同創辦人 Michael Chiang 指出：「記憶體容量一直是許多高階 AI 模型無法在終端裝置上順利運行的重要限制。群聯 aiDAPTIV 搭配 Intel AI PC 平台後，有機會讓使用者在地端執行遠超過原本硬體規格所能負擔的大型 AI 模型。」

LLMWare 共同創辦人暨技術長 Darren Oberst 認為：「企業生成式 AI 正快速朝向更實際的地端應用發展，包括 RAG、AI Agents，以及各種領域專屬模型。群聯 aiDAPTIV 的技術方向

相當有潛力，能協助 Intel AI PC 終端系統支援更大型模型與更高能力的地端 AI 應用，同時讓資料能更安全地留在使用者端。」

TurinTech AI 營運長 Kee-Meng Tan 提到：「透過與 Intel 及群聯合作，我們能將 AI 驅動的程序碼最佳化能力真正落實到裝置端（on-device）工作流程中，兼顧效能、隱私與成本控制。結合 Artemis、Intel AI PC 與群聯創新的記憶體架構後，即使不持續增加系統記憶體容量，也能支援更大型、更高能力的地端 AI 工作負載。」

Intel Client Computing 資深副總裁暨總經理 Jim Johnson 強調：「越來越多企業與使用者希望 AI 能在地端運行，不但速度更快、隱私性更高，也不用承擔持續將資料送往雲端所產生的成本。我們與群聯的合作，讓 Intel AI PC 平台能以更精簡的記憶體配置支援更大型的地端 AI 工作負載，協助客戶以更低的整體成本，把自身資料真正轉化為實際應用與商業價值。」

誠摯邀請各界蒞臨群聯於 COMPUTEX 的展位（南港展覽館一館 4 樓 M0411a），親身體驗 aiDAPTIV 技術展示。若欲安排會議或產品展示，請聯繫 sales@phison.com。

[群聯公告暨新聞稿訂閱]

如欲獲取群聯新聞稿或其它公告，請訂閱：[群聯投資人關係訊息訂閱](#)

[關於群聯的關鍵數字]

- 超過 25 年的 NAND 控制晶片暨 NAND 儲存方案整合經驗
- 全球超過 5000 位員工，且 70%以上為工程師
- 全球近 2000 個 NAND 儲存相關專利
- 透過 5+5 長期發展大戰略，驅動長期超越千億級營收
- SSD 控制晶片全球市佔率超過 20%
- 車用控制晶片全球市佔率超過 40%
- 群聯與日本 KIOXIA、美光 Micron、SanDisk、三星、SK Hynix、YMTC 等 NAND 原廠，均為長期合作夥伴。
- 超過 80%營收貢獻度來自於『高附加價值』的 NAND 儲存應用市場，包含伺服器、車載系統、嵌入式系統、工控應用、電競主機、生成式 AI 等，讓群聯能在 NAND 產業的波動變化下，依舊能維持相對穩定的營收與獲利。
- 群聯對整體 NAND 產業生態鏈的掌握（包含從上游的 NAND 原廠的雙向合作關係、至下游的 NAND 儲存應用客戶等），是群聯所能帶給全球客戶與夥伴的不可取代價值，也是群聯能在 NAND 產業屹立不搖的關鍵優勢。

[關於群聯電子]

群聯電子 (Phison Electronics Corp.) 長期深耕於 NAND 快閃記憶體控制晶片領域，為全球領先的 NAND 控制晶片與儲存解決方案供應商。隨著產業演進，群聯已由傳統控制晶片設計公司，成功轉型為結合 AI 運算與儲存技術的整合型平台服務商，專注於高附加價值與客製化市場。群聯憑藉深厚的韌體演算法、控制晶片設計與系統整合能力，提供從 IP 授權、晶片設計、系統架構、到整機解決方案的一站式服務，並廣泛應用於資料中心、AI 運算、企業級儲存、工業電腦與嵌入式系統等領域。透過與全球 NAND 原廠及策略夥伴的緊密合作，群聯致力於協助客戶加速產品導入 (Design-in)，打造具備高效能、高可靠性與差異化競爭優勢的儲存與 AI 應用解決方案。

歡迎拜訪 [群聯網站](#) 或 [群聯 Q&A](#) 以更好地了解群聯電子。

群聯電子發言人

于紹庭 Antonio Yu

TEL: 037-586-896 #10019

Mobile: 0979-105-026

Email: antonioyu@phison.com

群聯電子代理發言人

呂國鼎 Kuo-Ting Lu

TEL: 037-586-896 #26022

Mobile: 0979-075-330

Email: kuoting_lu@phison.com

[預測性陳述聲明]

本新聞稿所提供之資訊(除歷史資訊之外)屬於預測性陳述。在此敬告讀者，預測性陳述乃基於群聯之合理認知以及就現狀所作的預估，且將受到各種風險以及不確定因素影響，因此可能造成實際結果和預測性陳述之內容顯著不同。這些風險以及不確定性因素包括但不限於，供給與需求變化、產銷能力、開發成功、及時導入市場、市場競爭、產業循環、客戶財務狀況、匯率浮動、法律訴訟、法令變更、全球經濟變化、自然災害、其他可能會影響群聯業務與營運的不確定因素。鑑於此，讀者請勿倚賴預測性陳述。除法律另有規定外，無論是基於新資訊、未來事件或是其他因素，群聯皆無義務更新預測性陳述。